

# M-VIA Embedded<sup>®</sup> 部品内蔵基板

## Embedded Devices PWB

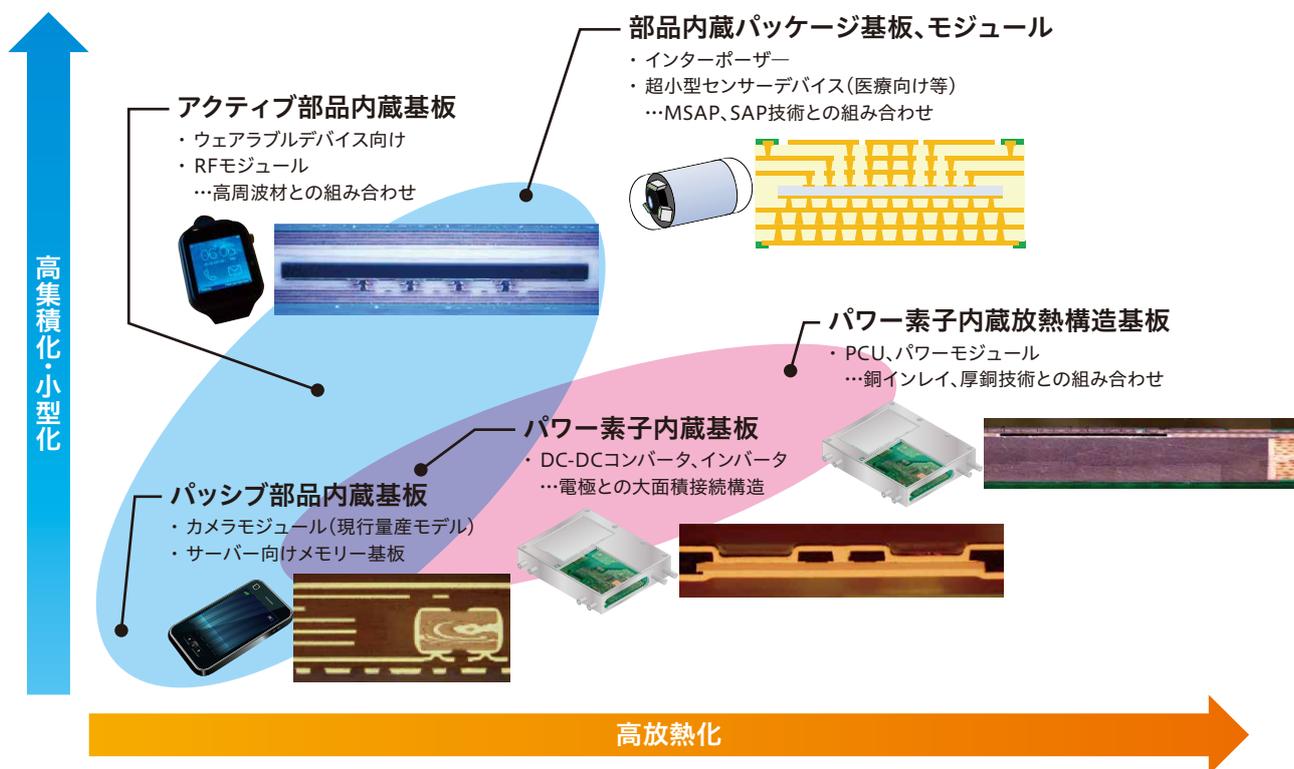
R&D

### 車載アプリケーション

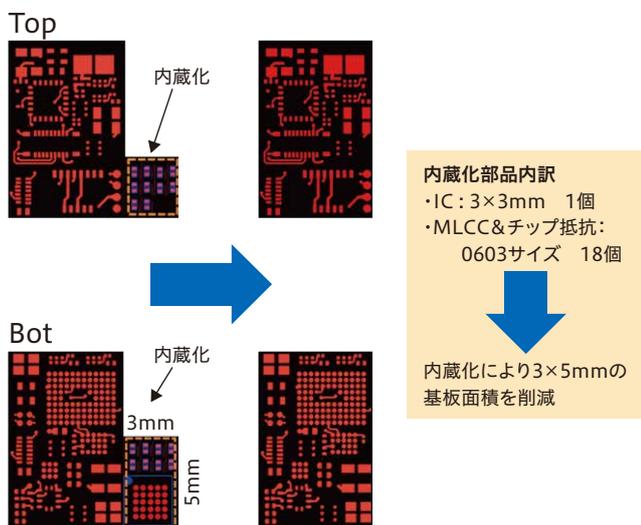
- 表面実装部品の内蔵化による小型化
- 発熱部品を放熱側へ内蔵し放熱効率をUP
- 配線距離の短縮によるON抵抗低減によりスイッチング性能のUP

### 民生アプリケーション

- 配線長の短縮により低インダクタンス化し、伝送特性を向上
- 基板面積の削減、高集積化
- 発熱部品を放熱側へ内蔵し放熱効率をUP



### 小型化事例



### 内蔵基材実績 (試作含む)

材料カテゴリ	材料名
一般FR4	パナソニック/R1566(量産)、昭和電工/679FGS(量産)等
高Tg材	三菱瓦斯/BT材、昭和電工/770G等
高周波材	パナソニック/MEG6、昭和電工/HS-100D等
★新規開発材料	高Tg材 (Tg260°C以上/DMA)

### 内蔵部品実績 (試作含む)

部品種		サイズ
受動部品	MLCC	0402~3216
	チップ抵抗	※量産実績:0603、1005
	バリスタ	0603
	NTCサーミスタ	0603
	水晶振動子	2016
能動部品	IC (WLCSF、ベアチップ)	厚み、サイズ別途ご相談
	パワー素子ベアダイ: MOSFET/IGBT/Diode	厚み、サイズ別途ご相談